

Единая система
электронных вычислительных машин

КОНСТРУКЦИИ БАЗОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Основные размеры

The unified system of electronic computers.
Base constructions of hardware.
Basic dimensions

ГОСТ
25122—82

[СТ СЭВ 1628—79]

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 февраля 1982 г. № 495 срок действия установлен

С 01.01 1983
ДО 01.01 1988

Die Nichtbeachtung des Standards wird gesetzlich verfolgt.

Vorliegender Standard gilt für Basiskonstruktionen technischer Mittel des ESER (TM ESER), die nach modularem Prinzip aufgebaut sind und bestimmt die allgemeinen Forderungen, Hauptparameter, die Konstruktionsebenen der Moduln, welche für den Einbau und Anordnung von Elektronik- Ausrüstungen der TM ESER vorgesehen sind. .

Vorliegender Standard ist vollständig identisch mit **ST RGW 1628—79**.
Begriffe, die in diesem Standard benutzt werden, sind im Auskunftsanhang aufgeführt.

1. Allgemeine Grundsätze

1.1. Basiskonstruktionen müssen den Forderungen gemäß GOST16325—76 entsprechen.

Anmerkung:

1. Es ist gestattet, Basiskonstruktionen nach den Maßen gemäß ST RGW 834—77 auszuführen.
2. Die Ausführung der Konstruktion von TM ESER nicht schrankähnlichen Typs und von Peripheriegeräten bestimmt sich nach den Forderungen an das konkrete Gerät.

1.2. Die Außenmaße von nicht demontierbaren Konstruktionen müssen die Möglichkeit bieten, sie durch Türöffnungen im Maße 1,8m X 1,1m sowie mit 90Grad Drehung aus Korridoren mit 1,1 m Breite in Türöffnungen, Treppenhäuser und Aufzüge bis 1,1 m Breite zu befördern.

1.3. Die Masse von nicht demontierbaren Konstruktionen darf 600 Kg nicht überschreiten.

1.4. Die Basiskonstruktion der TM ESER muss nach einem Modular- Prinzip aufgebaut sein, welches die Schaffung von unifizierten Montageeinheiten in verschiedenen technischen Mitteln gewährleistet.

1.5. Die Basiskonstruktionen müssen aus definierten konstruktiven Moduln bestehen, welche untergliedert werden auf die ihnen entsprechenden Konstruktionsebenen, die in Tab. 1 und Zeichnung 1 dargestellt sind.

Anmerkung:

Das Fehlen einzelner Ebenen im Bestand der Konstruktion konkreter TM ESER ist zulässig.

Tabelle 1

Ebene des Modul	Konstruktions- Modul
erste	Gehäuse des Integrierten SK (SSI, MSI LSI, Elektro- Bauelement)
Zweite	Typisiertes Austauschelement (TES) (Kassette, einzelner Einschub – Block, Paket von TES)
dritte	Paneel (Block- Rahmen) Spezial- Block
vierte	Rahmen
fünfte	Standgefäß (Schrank), Beistellschrank ,Pult

2. Konstruktionsmodul erste Ebene

2.1. Außenmaße und Anschlußparameter der Gehäuse für SK nach GOST 17467—79.

3. Konstruktionsmodul zweite Ebene

3.1 Die Konstruktionsebene des TES muss eine Leiterplatte sein.

3.2 Das TES ist als Zweiebenen – oder Mehrebenen- Leiterplatte auszuführen;

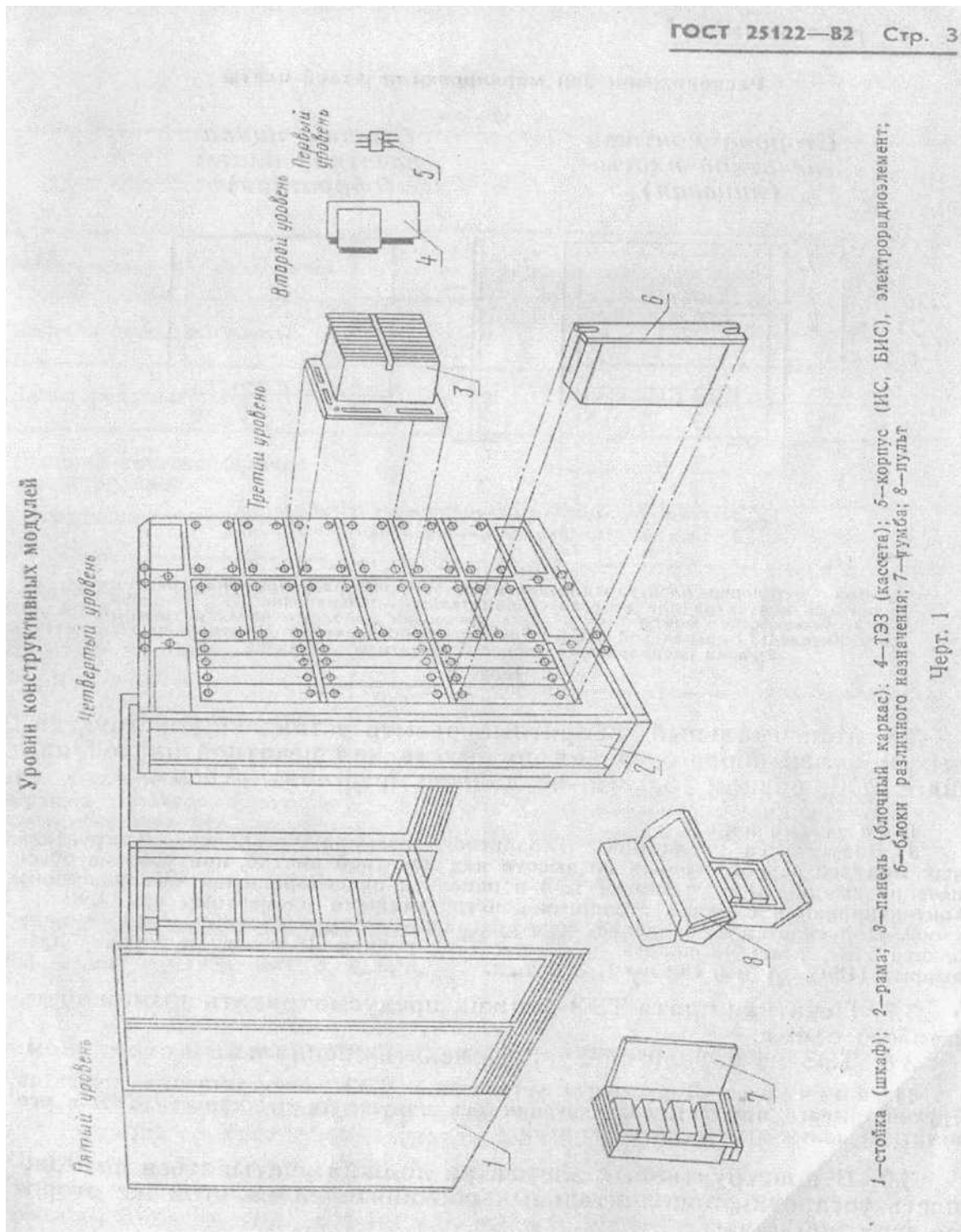
3.3 Die Außenmaße und die Hauptparameter der Leiterplatte des TES haben der Zeichnung 2 und Tabelle 2 zu entsprechen.

3.4 Die Anordnung der Zonen der Kennzeichnung der Leiterplatte , der Kontaktkämme oder Kontakt-Steckverbinder haben der Zeichnung 2 zu entsprechen.

Anmerkung.

der Einsatz von zusätzlichen Steckverbindern in den Zonen gem. Zeichnung 2 ist erlaubt;

3.5. Die Zentren der Bohrungen für die Montage-Elemente und deren Kontakte müssen sich an den Schnittpunkten des Koordinatensystems der Leiterplattenzeichnung befinden;

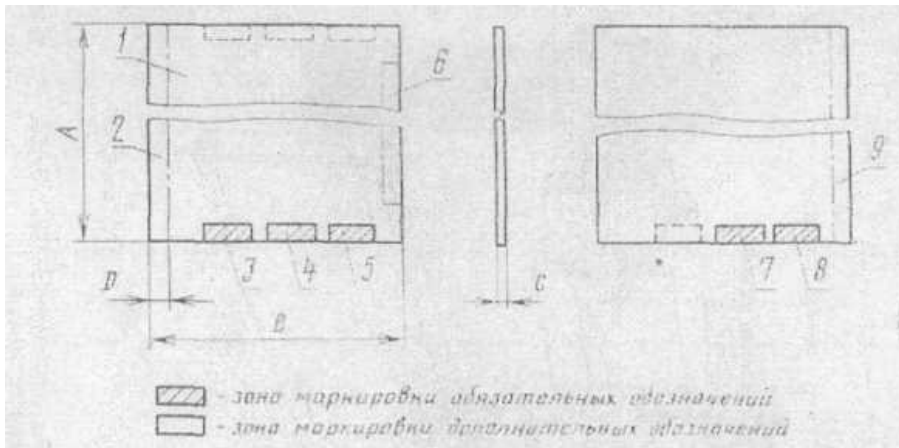


1- Standgefäß (Schrank); 2- Rahmen, 3 – Paneel (Block-Gehäuse), 4- TES (Kassette) 5- BE Gehäuse (IS, LSI- Gehäuse, Bauelement), 6- Blöcke verschiedener Zweckbestimmung, 7- Beistellschrank, 8- Pult.

Lage der Kennzeichnungs- Zonen der Leiterplatte.

Bestückungsseite der LP(Vorderseite)

Lötseite der LP (Rückseite)



1—Bestückungszone für Bauelemente ; 2—Zone der Anordnung der Kontaktkämme oder Steckverbinder; 3—Bezeichnung der LP; 4—Chiffre des TES ; 5—Werknummer des TES 6—Zone der zusätzlichen Steckverbinder ; 7— Werknummer der LP ; 8—Bezeichnung der LP 9—Zone der Anordnung der Kontaktkämme
 Zeichn. 2

3.6. Das maximale Außenmaß der konstruktiven Moduln der Ebene 1 in der Höhe über der Leiterplatte bei einem LP- Raster von 15 mm darf 8,5 mm nicht überschreiten.

Anmerkung:

1, Die Vergrößerung der Außenmaße der Moduln der Ebene 2 in der Höhe über der LP kann überschritten werden , sofern ausreichend Abstand beim Einsatz des TES im Paneel gegeben ist und der elektrische Kontakt mit anderen Konstruktionselementen oder TES ausgeschlossen ist.

2. Es ist erlaubt, die Konstruktionsmoduln der Ebene 2 als Paket auszuführen , wobei die Dicke des Paketes bei einem LP- Raster von 15,0 mm nicht größer sein darf als $(15n-2,0)$ mm, bei $n=2; 3$ usw. sein darf. .

3.7. Die LP muß eine Möglichkeit für deren Ausziehen (Herausziehen) bieten.

3 8. Das TES ist mit einer speziellen Auszugsvorrichtung zu ziehen;

Anmerkung:

Es ist erlaubt, am TES Konstruktionselemente (Griffe, Hebel u.a. .) anzubringen, die es ermöglichen , ohne Zerstörung der Ganzheitlichkeit des TES oder der LP diese ausziehen.

3.9. In den Konstruktionselementen muß die Möglichkeit eines Zusatzsteckverbinders auf der gleichen Seite der LP berücksichtigt werden.

Tabelle 2 / Maße in mm

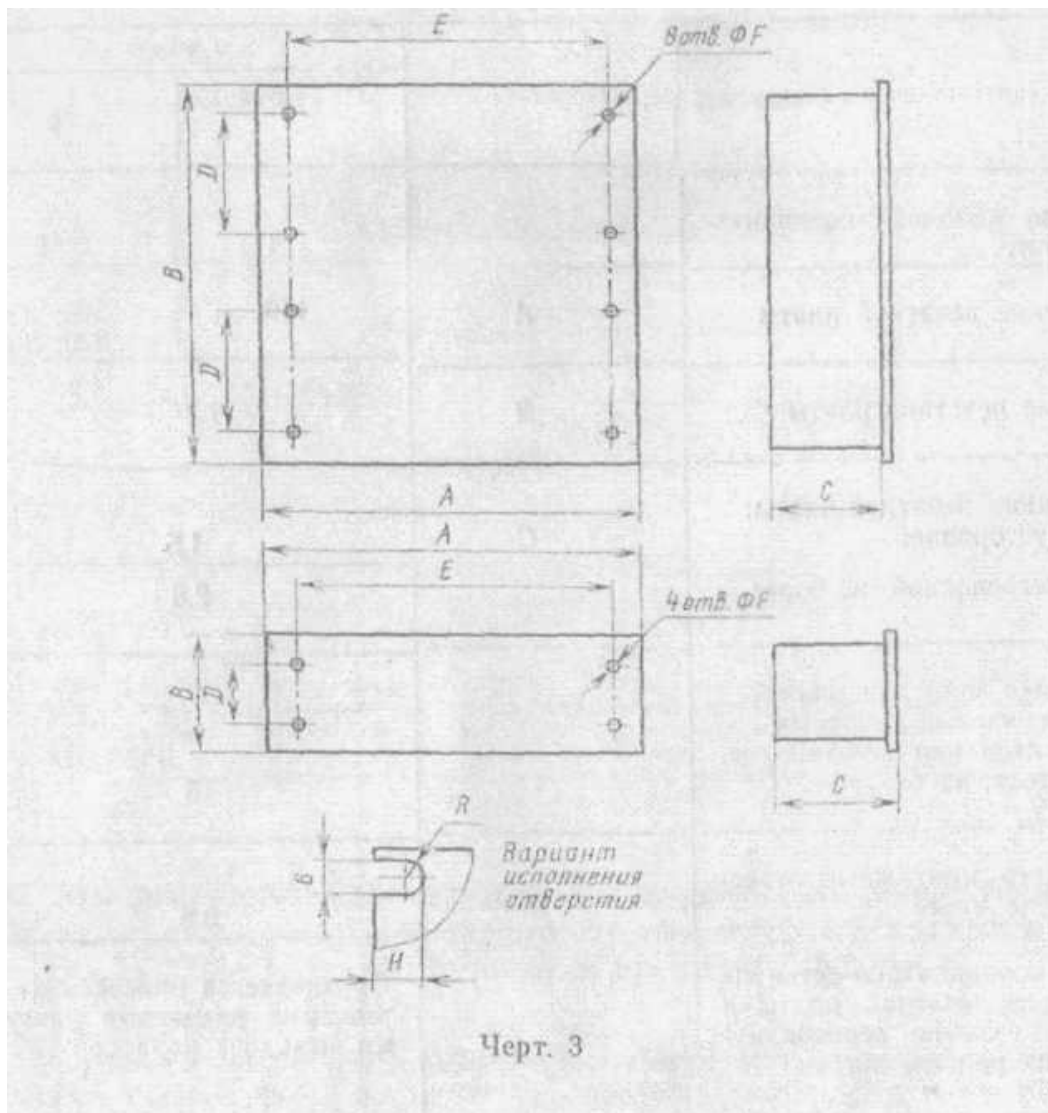
наимование параметра Bezeichnung	Обозначение Zeichen	Габарит Maße	
		1	2
Anzahl der Steckverbinder Stck. .	-	1	2
Breite der LP	A	140	300; 310; 320; 330
Länger der LP	B	150	
Dicke der LP: zweiseitig	C	1,5	
Mehrebenen, nicht mehr als		2,6	
Breite der Fläche der Kontaktkämme oder Steckverbindergehäuse, nicht mehr als	D	15	
Durchmesser der Montagebohrungen , nicht weniger als	E	0,8	
Raster des Koordinatennetzes der Zeichnung der LP in zwei othogonalen Richtungen	F	Bestimmt sich durch die Anschlußmaße (Kontaktraster) der IC – Gehäuse.	
A n m e r k u n g . Zusätzliche Raster des Koordinatennetzes Zeichn. 2 der LP —F/n , wo n=2, 3, 4, 5, 6			

4.. Konstruktionsmodul dritte Ebene

4.1. Die Hauptmaße der Paneele und von Blöcken verschiedener Bestimmung haben der Zeichnung 3 und der Tabelle 3 zu entsprechen;

4.2. Das Raster der Anordnung der TES im Paneel muß gleich 15,0 mm sein. In technisch begründeten Fällen ist ein Raster des Einsatzes der TES erlaubt , das $(15,0 \pm 2,5m)$ mm entspricht , wo $m=1; 2; 3$ usw. .

Hauptabmessungen von Paneelen verschiedener Zweckbestimmung



4.3. Es ist statthaft, Spezial- Blöcke mit (Paneel-) Leiterplatten mit folgenden Abmessungen der LP einzusetzen:

Breite $(140 \pm 5 \cdot K)$ mm , wobei $K=0, 1, 2, 3$ usw.;

Länge $(150 \pm 5K)$ mm, wobei $K=0, 1, 2, 3$ usw. ist .

4.4. Das Raster des Koordinatennetzes der Paneel- LP muß in zwei orthogonalen Richtungen 2,5 mm sein Die Montage- Durchmesser der Paneel- LP, die zur Montage von IC oder von Kontakten der Steckverbinder bestimmt sind, müssen mindestens 0,8 mm Durchmesser haben. .

Die Maße unrunder Löcher wird nicht vorgeschrieben.

Anmerkung.

Für Geräte , die keine Schrankgefäße nutzen, ist es erlaubt, Paneele und Blöcke verschiedener Zweckbestimmung zu nutzen mit Abmessungen, die es erlauben, die Paneele in die Aufnahmeöffnung („Fenster“) des 4. oder 5. Konstruktionsniveaus mit Abmessungen gem. Darstellung 4 und Tabelle 4 einzubauen.

Tabelle 3

Benennung des Parameter	Bezeichnung	Maße	
		1	2
Länge	A	386	386
Briete	B	358	178.
Tiefe der Blöcke mit verschiedener Zweckbestimmung, nicht mehr als	C	240	
Abszand zwischen den Befestigungsbohrungen.	D	150±0,3	
Durchmesser der Befestigungsbohrungen	F	6	
Maß der Nut in der Breite	G	6	
Maß der Nut in der Länge	H	10	
Radius der Nut	R	3	

5. Konstruktionsmodul vierte Ebene

5.1. Der Rahmen muß die Möglichkeit bieten , in ihm die Konstruktionsmoduln der 3. Ebene anzuordnen und darf nicht mehr als 9 Paneele nach Abmessung Typ 1 oder eine entsprechende Anzahl von Paneelen mit anderen Abmessungen aufnehmen.

Табелле 4

Benennung des Parameter	Bezeichnung	Maße
Hauptmaße des Fensters: Länge Breite	A B	360 360
Zusatzmaße des Fensters:		
Länge	$A_{\text{доп}}$	$A \pm A/6 * m$ bei $m=1, 2, 3$ и т. д.
Breite	$B_{\text{доп}}$	$B \pm B/4 * m$ bei $m=1, 2, 3$ и т. д.
Max. Länge des Fensters	$2A$	720
Max. Breite des Fensters	$3B$	1080